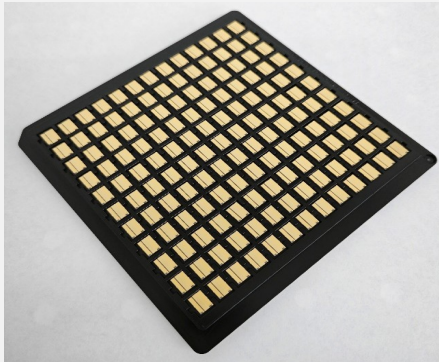




SiC 热沉

规格型号: DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-48



主要特性:

- 预制金锡焊料
- 单晶 SiC 基板, 热导率 $\geq 370\text{W/m}\cdot\text{K}$
- CTE 匹配芯片材料

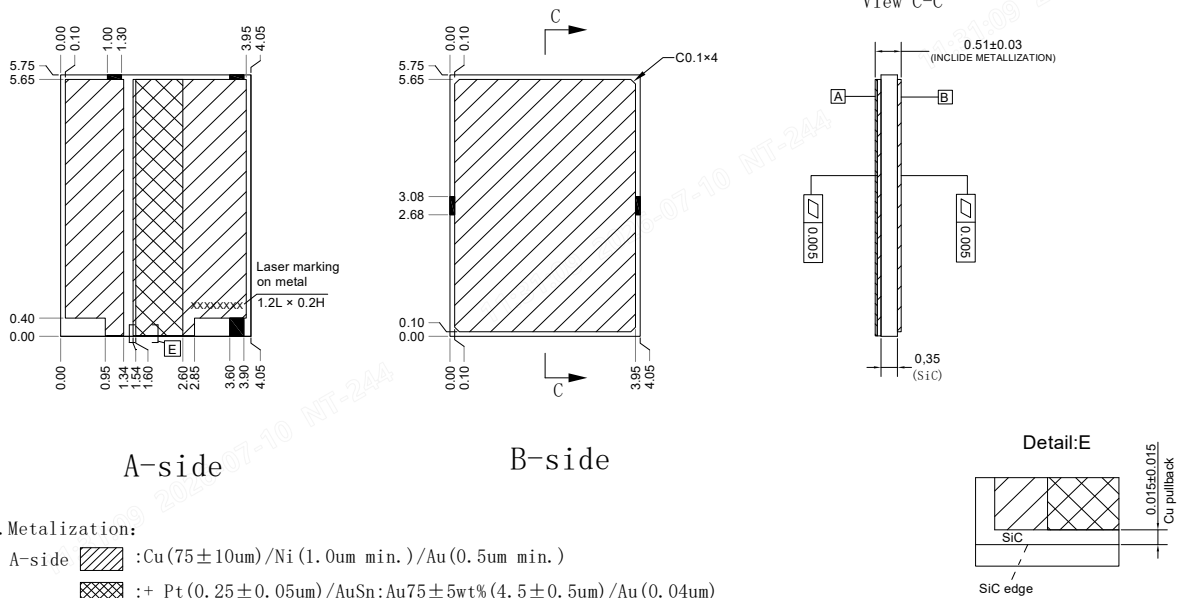


应用:

- 高功率激光芯片封装
- 科研与工程



详细图纸 (mm) :



1. Metalization:

- A-side :Cu (75 $\pm$ 10 μm)/Ni (1.0 μm min.)/Au (0.5 μm min.)
- B-side :Cu (75 $\pm$ 10 μm)/Ni (1.0 μm min.)/Au (0.5 μm min.)
- Edge :Thin film, Thickness $\leq 10\text{nm}$

2. Other tolerance: $\pm 0.05\text{mm}$

3. A/B Surface Roughness: Ra $\leq 0.1\mu\text{m}$

PARTS NAME	SiC Submount	DATE	2026-7-4
MODEL NAME	DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-48	SHEET	1/1
MATERIAL	SiC ($\geq 370\text{W/m}\cdot\text{K}$)	DRAWN	
DIMENSION	4.05 $\times$ 5.75 $\times$ 0.51T	CHECKED	
UNIT	mm	APPROVED	

Dogain Optoelectronic Technology (Suzhou) Co., Ltd.

度巨保留所有权利。为保证产品的卓越品质和可靠性,产品规格和描述可能随时更新。了解具体产品详情,请与我们的销售代表联系获取。



度巨核芯光电技术(苏州)股份有限公司

地址:苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城39栋

电话:0512-6179 0076, 邮箱:sales@dogain.com, 网址:www.dogain.com

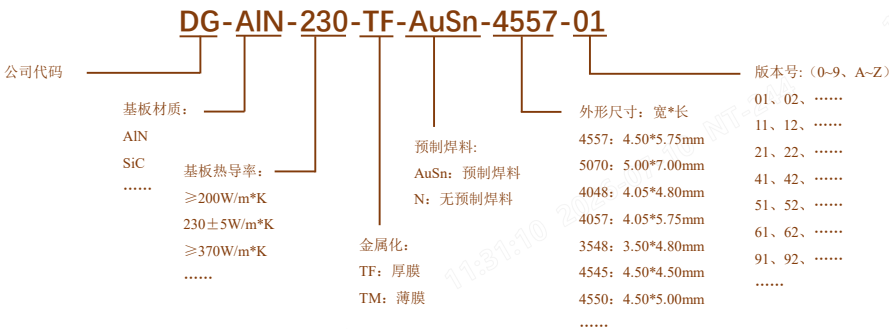


主要特征参数:

参数类别	单位	DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-48
长	mm	5.75±0.05
宽	mm	4.05±0.05
厚	mm	0.51±0.03
Cu pullback	mm	0.015±0.015
Cu 层厚度	um	75±10
Ni 层厚度	um	1.0 min.
Au 层厚度	um	0.5 min.
Au 层粗糙度	um	≤0.1
AuSn 层厚度	um	4.5±0.5
AuSn 组分	wt%	75±5(Au)
平面度	um	≤5
基板材质	\	单晶 SiC
基板热导率	W/m*K	≥370
存储环境	\	真空包装或氮气柜
存储温度	℃	25±15
存储湿度	%	≤60
保质期	年	1

备注:

- 1. 其他尺寸规格可定制;
- 2. 标准包装方式: 4 寸华夫盒装盘, 真空密封包装。
- 3. 规格型号说明:



度巨保留所有权利。为保证产品的卓越品质和可靠性, 产品规格和描述可能随时更新。了解具体产品详情, 请与我们的销售代表联系获取。



度巨核芯光电技术 (苏州) 股份有限公司
地址: 苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城39栋
电话: 0512-6179 0076, 邮箱: sales@dogain.com, 网址: www.dogain.com